

## 机遇与挑战，立足物联网产业链核心位置

### ■展芯销售部

如果说2017年拉开广域低功耗物联网的序幕，2018年是物联网的正剧，站在新一轮科技革命的风口，展芯销售部紧跟物联网的发展趋势，全面洞悉物联网产业链动态，快速掌握物联网的关键技术，敢做新时代的弄潮儿。

据工信部统计，2018年全球物联网市场规模超千亿，2020年总体产业规模突破万亿级。物联网发展迅猛，其产业链也较为复杂，通常以物联网组织架构（感知层、网络层、平台层和应用层）将产业链划分为8个环节：芯片供应商、传感器供应商、无线模组方案商、网络运营商、平台服务商、系统及软件开发商、智能硬件厂商、系统集成商及应用服务提供商。展芯销售部在这8个环节中占据比较重要板块，团队具有5年以上的MCU/MPU/无线通信/传感器等应用经验。芯片代理线可从提供芯片合作和咨询，到为客户提供PCBA ODM/OEM设计和生产服务，再到提供底层软件支持和程序烧写。模块化解决方案以客户应用需求为导向，实现定制化合作模式。提供端到端一站式解决方案，推动物联网发展，助力利尔达集团实现成为物联网解决方案领导者的长期战略目标。



H客户是安防领域的龙头企业，与利尔达合作数十年，一起见证物联网十年的发展。H客户不断发展壮大后，对产品功能的需求更多元化，原来有线的图像传输的方式不能满足布线复杂的应用场景，需新增无线传输方式。而无线的组网方式多样化，各家有各自的优势，需前期做大量的评估测试工作。利尔达工程师得知H客户需求后，针

对各种无线组网方式做了一次详细的培训和讲解，协助工程师快速熟悉。最终锁定可满足大数据量的传输的Wi-Fi模块，并针对当前H客户的图像数据传输要求，做定制开发。依托于展芯的元器件整合能力、先芯工厂的自主生产和技术对接服务能力，为客户定制Wi-Fi模块方案。该方案的整体优势突显，达成合作后该项目也成为Wi-Fi业内的标杆项目，之后又根据H客户的不同需求，定制多款Wi-Fi模块。合作过程中我们协助客户解决各种可能出现的技术难题，如CPU过载协助优化、硬件上板测试、EMC兼容性测试、协助产品FCC、CE无线认证、软件工程师软件底层开发培训等。另外针对H客户，还配合提供了RFID解决方案、电机控制解决方案等。

H客户的老总对利尔达笑赞：十年前你们仅是一家芯片代理商，今天不仅成长为技术增值服务代理商，还是一家涵盖物联网全套解决方案的科技公司。

芯片代理现今的商业环境竞争激烈程度与日俱增，利润不断挤压，来自客户端资金链压力越来越重，信息不对称和资源垄断的壁垒逐渐打破，行业巨头不断并购和压制。作为代理商的我们即迎接着物联网的红海期，同时也面临日益增长的竞争压力，未来芯片代理行业一定是强者愈强，资源集中化。我们不断的尝试打破行业壁垒，打通产业链的8大环节，代理产品线全面涵盖MCU+PLUS，各品牌间形成互补和增强，再增加产品细分市场的增值服务能力。不断锤炼自身的核心竞争力，迎接机遇和挑战，在物联网产业的核心位置稳稳立足。